Objektiv k bočnímu prohlížení BGA 90°, s ultra malou sondou OP-006 570

Obj. číslo:	106001785
Dostupnost:	4 týdny



Popis

Objektiv k bočnímu prohlížení BGA 90°. Používá se ke kontrole pájených spojů na součástkách BGA, µBGA, CSP a lícních čipech. Optická hlava se dostane na plochu pouze 0.4 x 3.4 mm.

Obsah balení

Objektiv k bočnímu prohlížení BGA s nízkou clonou a ultra malou optickou sondou.

Ochranné kryty.

Uživatelská příručka.

Technická data

Název parametru	Hodnota
Zvětšení	~ 350x - 25x
Zorné pole	~ 1.0 - 20 mm
Osvětlení	přední vestavěné LED osvětlení, zadní připojitelné LED osvětlení, volně stojící kartáčkové LED osvětlení
Napájení	řední světlo pomocí kamery (USB2.0 z PC), zadní světle pomocí externího napájení, kartáčkové osvětlení pomocí baterie nebo externího napájení
Rozměry (š x h x v)	165 x 50 x 36 mm
Hmotnost	200 g
Zobrazení	boční zobrazení BGA, objektivy

PDF generováno automaticky: **11.11.2026** Má pouze informativní charakter.
Zdroj:https://www.abetec.cz/eshop/product/objektiv-k-bocnimu-prohlizeni-bga-90-s-ultra-malou-sondou-op-006-570/